2011年3月期中間決算説明会

2010年11月1日 東京エレクトロン デバイス株式会社

Lechnical Support

決算報告

連結業績

	2010年3月期		2011年3月期		増減率
	中間	百分比%	中間	百分比%	(率)
売上高	40,923	100.0	45,535	100.0	11.3
売上総利益	6,293	15.4	7,726	17.0	22.8
営業利益	615	1.5	1,150	2.5	87.0
経常利益	620	1.5	1,247	2.7	100.8
中間純利益	308	0.8	861	1.9	179.1
1株当たり中間純利益	2,912.61円		8,129.19円		
ROE	2.9%			7.8%	
従業員数		845人		879人	

9月24日 中間連結業績を上方修正

	2010.4.28 年初発表 (A)	2010.9.24 修正発表	2011年3月期 中間実績 (B)	増減額 (B)-(A)	增減率 (%)
売上高	43,500	45,500	45,535	2,035	4.7
営業利益	870	1,050	1,150	280	32.3
経常利益	850	1,150	1,247	397	46.7
中間純利益	490	760	861	371	75.9

連結資産

科目	2010年 3月31日現在	2010年 9月30日現在	増減額
現預金	1,621	1,386	234
受取手形·売掛金	20,890	20,528	362
たな卸資産	15,636	18,949	3,312
その他流動資産	2,987	3,076	88
有形固定資産	1,121	1,121	1
無形固定資産	464	438	26
投資その他の資産	2,925	2,850	75
資産計	45,649	48,351	2,702

連結負債·純資産

科目	2010年 3月31日現在	2010年 9月30日現在	増減額
買掛金	7,255	7,956	700
短期借入金	5,105	6,608	1,502
その他流動負債	6,177	5,822	354
固定負債	5,198	5,425	226
負債計	23,737	25,813	2,075
資本金	2,495	2,495	-
資本剰余金	5,645	5,645	-
利益剰余金	13,903	14,499	596
評価·換算差額等	132	102	30
純資産計	21,911	22,538	626
負債·純資産計	45,649	48,351	2,702

連結キャッシュ・フロー

	2010年3月期 中間	2011年3月期 中間	増減額
営業キャッシュ・フロー	1,364	1,316	47
投資キャッシュ・フロー	60	145	84
財務キャッシュ・フロー	1,336	1,247	89
現金及び現金同等物 中間期末残高	1,151	1,386	234

セグメント別 連結売上高

セグメント	2010年 中	3月期 間	2011年 中	対前年増減率	
ピクトノト	売上高	構成比 (%)	売上高	構成比 (%)	(%)
半導体及び電子デバイス事業	32,661	79.8	37,475	82.3	14.7
コンピュータシステム関連事業	8,262	20.2	8,059	17.7	2.4
合 計	40,923	100.0	45,535	100.0	11.3

Technical Support

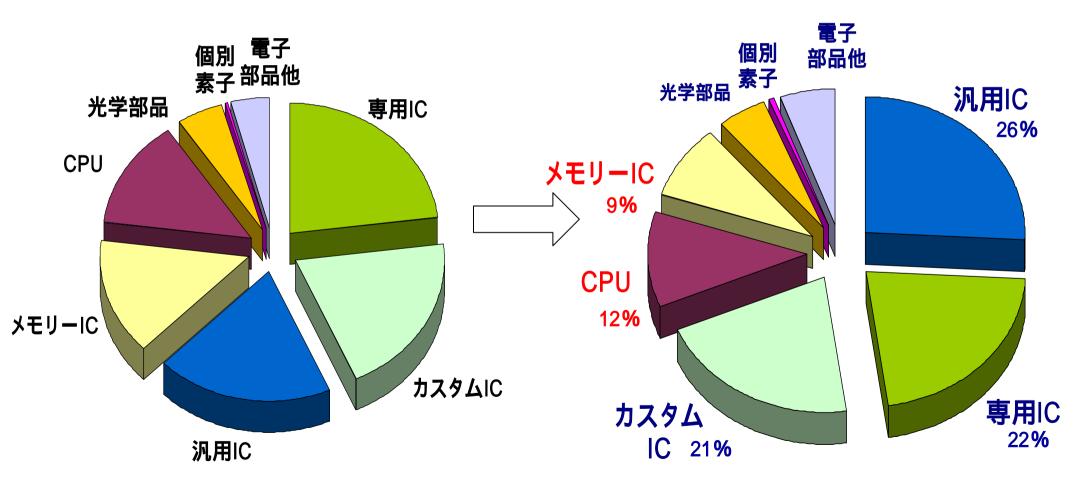
半導体及び電子デバイス事業

半導体及び電子デバイス事業 品目別売上構成

< 2010年3月期中間 内訳 >

売上高: 32,661百万円

< 2011年3月期中間 内訳 > 売上高: 37,475百万円



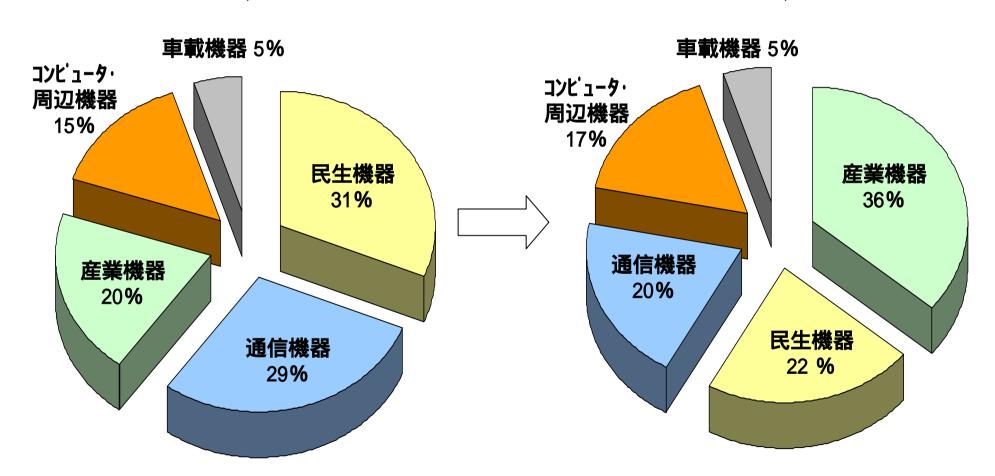


半導体及び電子デバイス事業 品目別 売上増減

主な品目	主な仕入先	対前年 増減率	主な要因
汎用IC	リニアテクノロシ˙ー、TI	55%	産業機器向け中心に全分野で増加
専用IC	ヒ'クセルワークス、ヒ'クシス、 シリコンイメーシ'、フリースケール	9%	液晶プロシェクタ、複合プリンタ、 AVアンプ向け増加
カスタムIC	ザイリンクス、富士通	16%	医療機器、製造装置等の産業機器 向け増加
CPU	フリースケール、富士通、TI	1%	デジタル家電向け減少
メモリーIC	スパ [°] ンション、I D T	29%	仕入先から供給不安を受け デジタル家電向け減少

半導体及び電子デバイス事業用途別売上構成

< 2010年3月期中間 内訳 > 売上高: 32,661百万円





< 2011年3月期中間 内訳 >

売上高: 37,475百万円

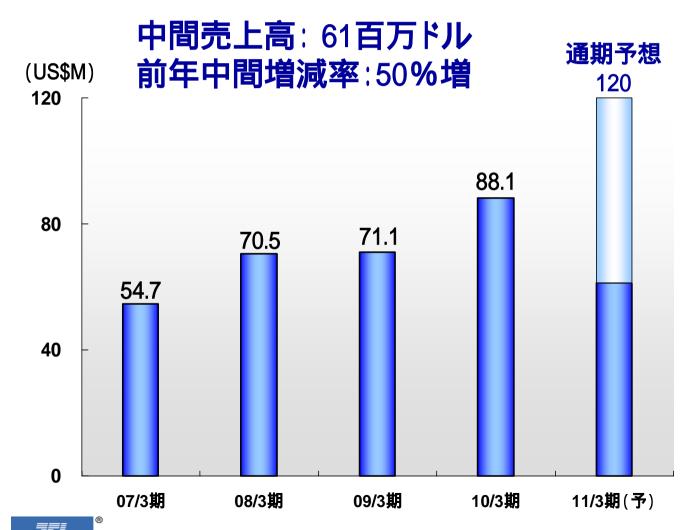
半導体及び電子デバイス事業 用途別傾向

用途	主なアプリケーション	当社の傾向
産業機器	医療機器、放送機器、テスター、 半導体製造装置、ロポット、 計測器、工作機器	産業機器全分野好調
民生機器	デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、 薄型TV、AV機器	エコポイント需要に一服感
通信機器	携帯電話、ルーター、伝送装置、 基地局	基地局、携帯電話ともに低調 商権移管の影響
コンピュータ・周辺機器	複合プリンター、液晶プロジェクタ、 PC及び付属機器	複合プリンター堅調 PC、液晶プロジェクタ回復
車載機器	カーナビケーション、カーオーディオ	カーナビケーション堅調

海外ビジネス

【海外連結子会社 売上高推移】

【営業拠点】





Lechnical Support

開発ビジネス



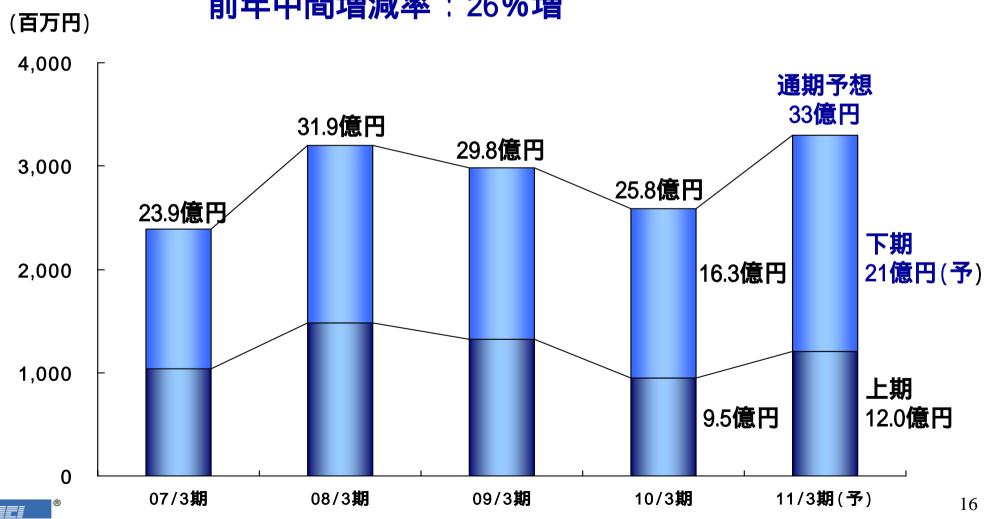
(インレビアム)

インレビアム売上高推移



中間売上高:12億円

前年中間増減率:26%増



インレビアム商品 開発例



FPGA搭載 LSI開発支援用評価ボード

- ・最大規模FPGA(ザイリンクス社製Virtex-6)や 高速メモリDDR3を搭載
- ・開発期間の短縮に効果を発揮
- ・2010年6月販売開始



< 主な応用分野 > 3Dテレビや 高画質映像機器など

TB-6V-LX760-LSI



Lechnical Support

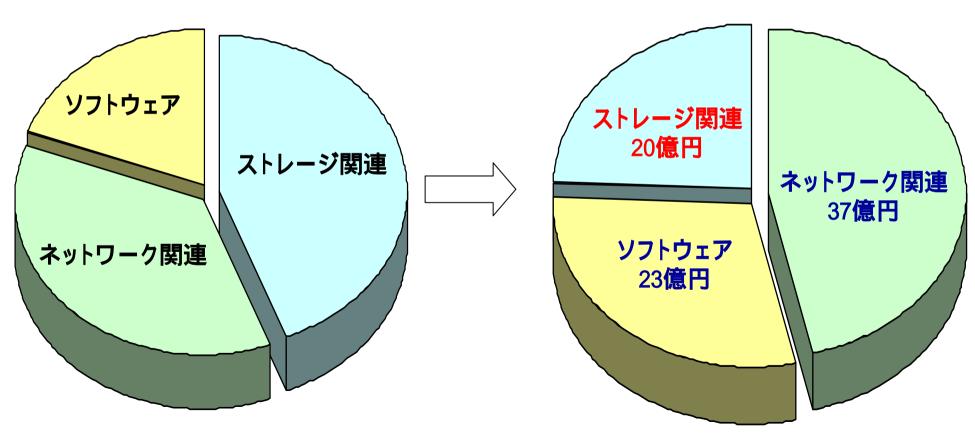
コンピュータシステム関連事業

コンピュータシステム関連事業 品目別 売上構成

< 2010年3月期中間 内訳 >

売上高: 8,262百万円

< 2011年3月期中間 内訳 > 売上高: 8,059百万円



コンピュータシステム関連事業 品目別売上増減要因

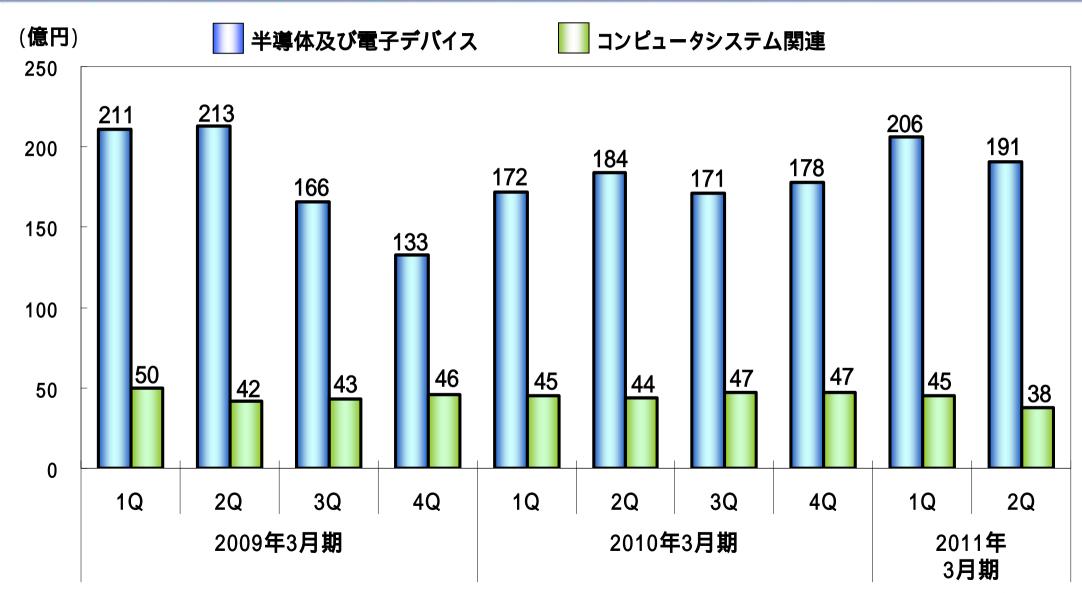
品目	主な仕入先	対前年 増減率	主な要因
ネットワーク関連	F5ネットワークス	24%	製品販売回復、保守堅調
ソフトウェア	マイクロソフト	46%	POS端末向けソフトウェア増加
ストレージ関連	プロケード	46%	IT投資の抑制および 商流の変更による減少

注)社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

Technical Support

足元の業況及び今期の業績見込み

受注高推移



当社を取りまく事業環境

【半導体及び電子デバイス事業】

- ·上期:産業機器の回復顕著 第1四半期好調、第2四半期一服感
- ・下期:一部用途には減速懸念あるが、 足元の状況は総じて底堅く、堅調持続を想定

【コンピュータシステム関連事業】

- ・上期:企業のIT投資は慎重 製品販売は回復途上だが想定どおり 保守は堅調
- ・下期:下期偏重の傾向あり、回復を想定



セグメント別 連結売上高予想

	中間 下期 通期		対前年	F通期	
セグメント	実績予想		増減額	增減率 (%)	
半導体及び 電子デバイス事業	37,475	37,525	75,000	7,560	11.2
コンピュータ システム関連事業	8,059	9,941	18,000	293	1.7
合 計	45,535	47,465	93,000	7,854	9.2

2011年3月期 連結業績予想

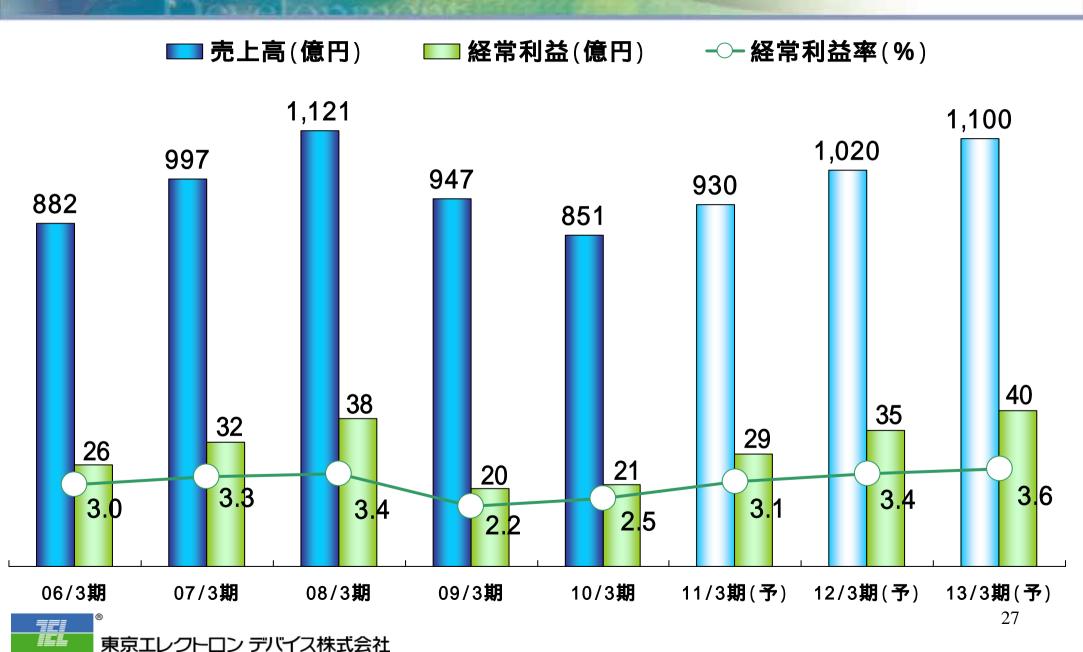
	中間	下期	通期	対前年	F通期
	実績	予想	予想	増減額	增減率 (%)
売上高	45,535	47,465	93,000	7,854	9.2
営業利益	1,150	1,720	2,870	790	38.0
経常利益	1,247	1,653	2,900	782	37.0
当期純利益	861	1,049	1,910	743	63.8

Technical Support

3ヶ年計画

2010年7月29日 発表 事業環境の変化に速やかに対応するため ローリング方式の3ヶ年計画を今年度から開始

業績推移及び3ヶ年計画



1. 半導体及び電子デバイス事業

新規顧客獲得

拠点拡充による地域密着営業の一層推進 産業機器分野(医療、環境など)に注力

商権拡大

技術サポートの充実により既存顧客を深耕

有望マーケットであるアジア地域での拡販 営業拠点の拡充 現地企業への営業強化



1. 半導体及び電子デバイス事業

開発ビジネス

設計受託業務、OEM販売の推進 量産供給及び品質体制の強化 トップセールスによる顧客拡大

自社プランド商品の拡販 セキュリティ関連向け商品群の拡充 アジア地域への販売推進

2.コンピュータシステム関連事業

お客様に密着した提案営業を強化 製品別営業からお客様別営業に組織改編 全国21箇所の営業拠点を活用

需要が高まるデータセンター向けビジネスに注力 システム構築、製品販売、保守のトータル提案

3.新規事業及び商材

環境エネルギー等成長分野への進出 LED、電池などの取り扱いを開始 リンクラブス社

インフィニット・パワー・ソリューションズ社

インテル社と代理店契約

資料取扱い上の注意

このプレゼンテーションで述べられている将来の当社事業に関する見通 しは、現時点で知りうる情報をもとに構築されたものです。

当社の参画するエレクトロニクス業界及びIT業界は変化のスピードが大変速く、また、世界経済、半導体市況など、当社の業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。

したがいまして、今後当社の業績見通しが本プレゼンテーションと異なる可能性があることをお含みおきください。また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。

品目別仕入先名

セグメン	ト·品目	主な仕入先名
	専用I C	カビウム・ネットワークス社、コネクサントシステムス'社、フリースケール・セミコンダウタ社、 富士通セミコンダクター(株)、インターシル社、ピクセルワークス社、シリコンイメーシ'社、 ピクシスシステムス'社、 サ'ーリンク・セミコンダクター社、インレビアム
	カスタムI C	富士通セミコンダクター(株)、ザイリンクス社、インレビアム
半導体及び	汎用I C	リニアテクノロシ´ー社、オン・セミコンダ`クター社、TI 社
電子デバイス	メモリーI C	IDT社、ラムトロンインターナショナル社、スパンション社
事業	CPU	フリースケール・セミコンダクタ社、富士通セミコンダクター(株)、TI 社
	光学部品	アパコ゚・テクノロシ゚ー社
	個別素子	オン・セミコンダウター社
	電子部品他	コーセル(株)、インレヒ・アム
	ネットワーク機器	エクストリームネットワークス社、F5ネットワークス社
コンピュータシステム 関連事業	ストレージ関連	プロケード社、エミュレックス社
大)	ソフトウェア	マイクロソフト社、オラクル社、センセージ社

用語説明(1)

品目	主な取扱商品	機能
専用IC	画像処理用IC 通信用・ネットワーク用IC	特定用途用に作られた専用I C
カスタムIC	ASIC, PLD	お客様の仕様に応じて作られる固有I C
汎用IC	汎用リニアIC(アナログIC) 汎用ロシックIC	色々な用途に共通に使用されるI C
メモリーIC	DRAM、SRAM フラッシュメモリ	記憶用IC、書込み、読出しが可能なものや 読出しのみのものがある
CPU	マイクロプロセッサ、DSP	電子機器の頭脳、演算機能・制御機能
光学部品	発光ダイオード、フォトカプラ	電気を光に変換して使用する電子部品
個別素子	整流素子、トランジスタ	増幅、整流などの機能を持つ部品
電子部品他	ボード、電源、コネクタ	プリント配線基板上にIC、電源、コネクタなどの 部品を実装した製品(ポード)

用語説明(2)

インターネット接続機器(負荷分散、セキュリティ) 企業向けネットワークシステム構築機器。 ネットワーク関連 SAN(ストレージエリアネットワーク)スイッチ、 ストレージ関連 SAN接続機器、ストレージセキュリティ機器など。 企業向け産業機器に組み込まれるマイクロソフト 社のソフトウェア。 ソフトウェア セキュリティ用ログ長期保存・分析ミドルウェア。

